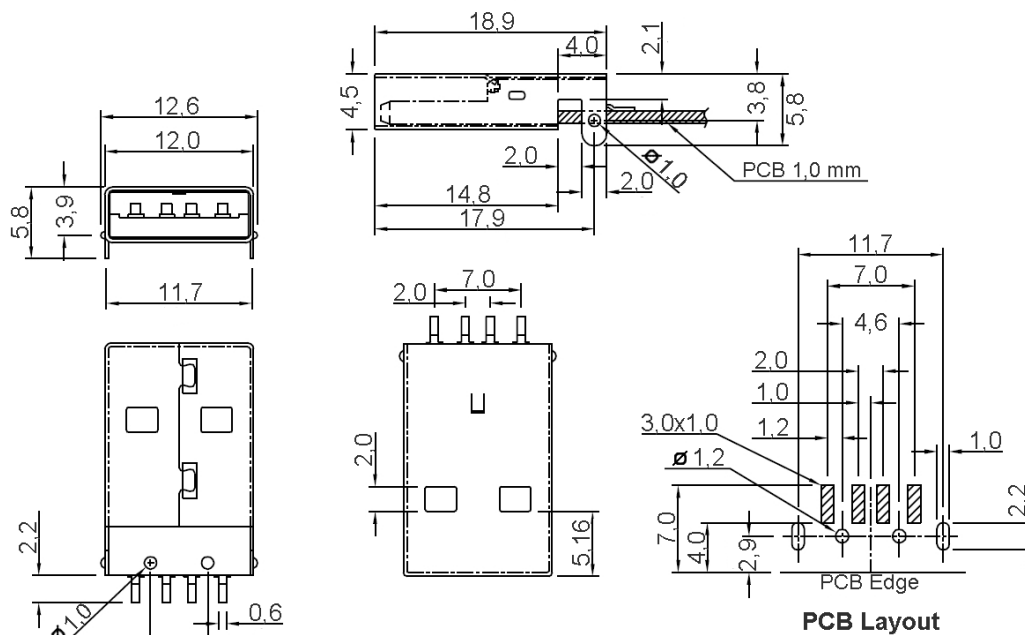
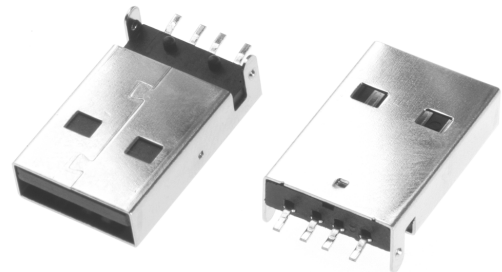


**Technische Daten / Technical Data:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Isolierkörper          | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0               |
| Insulator              | Thermoplastic, rated UL94V0                             |
| Gehäuse                | Edelstahl   |
| Shell                  | Stainless Steel   |
| Kontaktmaterial        | Phosphorbronze  |
| Contact Material       | Phosphor Bronze   |
| Kontaktoberfläche      | Gold über Nickel (siehe Optionen unten)                 |
| Contact Surface        | gold over nickel (see options below)                    |
| Oberfläche Lötanschluß | Zinn über Nickel  |
| Plating Solder Side    | tin plated over nickel                                  |
| Lötbarkeit             | IEC512-12A  |
| Solderability          | IEC512-12A  |
| Durchgangswiderstand   | ≤ 30 mOhm   |
| Contact Resistance     | ≤ 30 mOhm   |
| Isolationswiderstand   | > 5x10 <sup>8</sup> Ohm                                 |
| Insulation Resistance  | > 5x10 <sup>8</sup> Ohm                                 |
| Spannungsfestigkeit    | 500 V <sub>AC</sub>                                     |
| Test Voltage           | 500 V <sub>AC</sub>                                     |
| Nennstrom              | 1 A   |
| Current Rating         | 1 A   |
| Nennspannung           | 30 V <sub>AC/DC</sub>                                   |
| Voltage Rating         | 30 V <sub>AC/DC</sub>                                   |
| Temperaturbereich      | -40°C...+105°C  |
| Temperature Range      | -40°C...+105°C  |
| Verarbeitung           | Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T |
| Processing             | Reflow-Soldering, further informations in chapter T     |

**Series****Colour\*****Plating\***

8230

20

60

10 = schwarz  
black  
20 = beige  
ivory

60 = sel. Au / Sn  
80 = sel. Au 0,75 µm / Sn

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.)

\* Order example - To be replaced by your specifications.)

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow-Soldering Informations

### Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

| Profil Eigenschaft  | Bleifreies Lötten                 |
|---|-----------------------------------|
| Durchschnitts-Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )   | 3 °C / Sek. Max.                  |
| Vorheizen<br>- Temperatur Min ( $T_{s_{min}}$ )<br>- Temperatur Max ( $T_{s_{max}}$ )<br>- Zeit ( $t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$ ) | 150°C<br>200°C<br>60-180 Sekunden |
| Verbleiben oberhalb:<br>- Temperatur ( $T_L$ )<br>- Zeit ( $t_L$ )  | 217°C<br>60-150 Sekunden          |
| Peak/Klassifizierung Temperatur ( $T_p$ )   | 260°C +/- 5°C                     |
| Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur ( $t_p$ )   | 20-40 Sekunden                    |
| Ramp-Down Rate  | 6°C / Sekunde max.                |
| Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur   | 8 Minuten max.                    |

© W+P PRODUCTS

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):*

| Profile Feature  | PB-Free assembly                 |
|--|----------------------------------|
| Average Ramp-Up Rate ( $T_{s_{max}}$ to $T_p$ )  | 3 °C / second max.               |
| Preheat<br>- Temperature Min ( $T_{s_{min}}$ )<br>- Temperature Max ( $T_{s_{max}}$ )<br>- Time ( $t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$ ) | 150°C<br>200°C<br>60-180 seconds |
| Time maintained above:<br>- Temperature ( $T_L$ )<br>- Time ( $t_L$ )  | 217°C<br>60-150 seconds          |
| Peak/Classification Temperature ( $T_p$ )  | 260°C +/- 5°C                    |
| Time within 5°C of actual Peak Temperature ( $t_p$ )   | 20-40 seconds                    |
| Ramp-Down Rate   | 6°C / second max.                |
| Time 25°C to Peak Temperature  | 8 minutes max.                   |

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

*Recommended Reflow-Soldering profile:*



T